Inhaltsverzeichnis

Neue Baugruppentechnologie auf Basis von Dünnglaslaminaten (invited) **14**
W. Scheel, H Schröder,.Fraunhofer IZM, Berlin

“glassPack” – Funktionalisierungs-, Strukturierungs- und Fügetechnologien für Dünnglasfolien **18**
N. Arndt-Staufenbiel, L. Brusberg,; H.Schröder, Fraunhofer IZM Berlin

Optoelectronics system integration by soldering on ceramic PCB **22**
E. Beckert, H. Banse, R. Eberhardt,A. Tünnermann, Fraunhofer AOF Jena, F. Buchmann, Askion GmbH, Gera

Wie sieht das Packaging von ROSA/TOSA der nächsten Modulgeneration >10G aus **25**
K. Schulz, MergeOptics Berlin

NoE ePIXnet / Platform for Photonic Packaging Technology **29**
L. Zimmermann, TU-Berlin

Novel VCSEL-Based Transceiver Chips for Bidirectional Optical Interconnects Using Butt-Coupled Multimode Fibers **33**
R. Michalzik; M. Stach; F. Rinaldi; and S. Lorch, Universität Ulm

A Silicon Optical Bench for Optical Feeding an LTCC based Wireless Transceiver **38**
R. Gindera, L. Pergola; R. Vahldieck; and D. Jäger, Uni Duisburg

Assembly and Test of Optical Chips on Wafer Scale **42**
J. Kropp, EZCONN GmbH, Berlin

Reliability of Wave Guide Integrated Photo-detectors in High Temperature Operation **45**
M. Kroh, G. Unterbörsch, M. Harnisch, G. Tsianos, M. Junge, A. Umbach U2T Berlin

Integrated injection moulded devices for polymeric fiber systems **47**
J.-U. Just, M. Haupt, U. Fischer-Hirchert, Hochschule Harz, HarzOptics GmbH Wernigerode

Hybrid Integration Technology on Polymer Platform **51**
N. Keil, H. H. Yao, C. Zawadzki, W. Schlaak, M. Möhrle, N. Grote, R. Schmidt
Heinrich-Hertz-Institut (FHG), ELBAU Elektronik Bauelemente GmbH Berlin

Konzeption, Umsetzung und Qualifizierung der automatisierten Montage elektrooptischer Bauelemente **55**
M. Rösch, D. Craiovan, Uni-Erlangen